

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年4月6日(06.04.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/053566 A1

(51) 国際特許分類:
C09J 163/00 (2006.01) *C09J 175/04* (2006.01)
C09J 7/35 (2018.01) *H01L 21/301* (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01) *H01L 21/52* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2022/020970

(22) 国際出願日: 2022年5月20日(20.05.2022)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2021-157430 2021年9月28日(28.09.2021) JP

(71) 出願人: 古河電気工業株式会社(**FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.**) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 森田 稔(**MORITA, Minoru**); 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 弁理士法人イイダアンドパートナーズ, 外(**IIDA & PARTNERS et al.**); 〒1050004 東京都港区新橋3丁目1番10号 石井ビル3階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,

QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) **Title:** COMPOSITION FOR ADHESIVE AGENT, FILM-LIKE ADHESIVE AGENT, SEMICONDUCTOR PACKAGE USING FILM-LIKE ADHESIVE AGENT, AND PRODUCTION METHOD THEREFOR

(54) 発明の名称: 接着剤用組成物及びフィルム状接着剤、並びに、フィルム状接着剤を用いた半導体パッケージ及びその製造方法

(57) **Abstract:** Provided is a composition for an adhesive agent, the composition containing an epoxy resin (A), an epoxy resin curing agent (B), a polyurethane resin (C), and an inorganic filler material (D), wherein: the polyurethane resin (C) has a $\tan\delta$ peak top temperature of at least 0 °C in a dynamic viscoelasticity measurement; and the proportion of the polyurethane resin (C) in the total content of the epoxy resin (A) and the polyurethane resin (C) is 2-50 mass%.

(57) 要約: エポキシ樹脂(A)、エポキシ樹脂硬化剤(B)、ポリウレタン樹脂(C)及び無機充填材(D)を含有し、前記ポリウレタン樹脂(C)が、動的粘弾性測定における $\tan\delta$ のピークトップ温度が0℃以上であり、前記エポキシ樹脂(A)と前記ポリウレタン樹脂(C)の各含有量の合計に占める前記ポリウレタン樹脂(C)の割合が2~50質量%である、接着剤用組成物。



WO 2023/053566 A1